

TEAM-100ARF

全自動真空フィルム貼付装置(内貼タイプ)
Full-Automatic Dry-resist film Laminator

【概要 - Outline -】

◆本装置はドライレジストフィルムをはじめとする多種多様なフィルムのラミネートをウェーハに対して内周に全自動で行う装置です。
This machine is for laminating dry-resist film inside the circumference of a wafer as a part of the wafer resisting process.

【特長 - Features -】

- ◆真空状態でフィルムとウェーハを貼付けることにより、段差に対しても気泡の発生が無い貼り付けができます。
Laminating film in a vacuum chamber prevents bubbles on the film as well as damages to the wafer.
- ◆ドライレジストフィルム化する事により従来のウェットレジスト工程でのレジスト液の無駄を大幅に軽減できます。
Dry-resist film saves resist solution drastically in the conventional wet resist process.
- ◆ウェーハ内周に設定したフィルムサイズにカットする事で、メッキ電極に対応してウェーハ周辺部を露出する事が出来ます。
Cutting film smaller allows the exposed area on a wafer edge part in accordance with the plate electrode.



仕様 Specification	TEAM-100ARF	
スループット Throughput	フィルム及びご使用条件により異なります Depending on film type and using conditions.	
対応ウェーハサイズ Wafer Size	5インチ・6インチ・8インチ	
使用フィルム幅 Film Width	5インチ：150～160mm / 6インチ：180～200mm / 8インチ：225～230mm	
ユーティリティ Utilities	電源 Power	AC100V 単相 50 / 60Hz 3.0KVA
	空気源 air	圧力 0.5～0.8Mpa 100NI/min
	真空源 Vacuum source	-74Kpa
装置寸法 Demension	D 1,190×W1,490×H1,660 mm (シグナルタワー含まず)	
重量 Weight	600kg	

※ 外観・仕様は改良の為、予告なく変更する場合があります。
System appearance and specifications are subject to change without prior notice from the supplier.